



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。

クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE

1 ポストの表面処理

① リン酸処理

水洗・乾燥

5秒間処理



例えば
①



② シラン処理 (「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」)

塗布・エアブローで乾燥

待ち時間なしでエアブロー



③

関連商品

- 歯科用エッチング材 ① K エッチャント シリンジ
- 歯科根管用ポスト ② クリアフィル® AD ファイバーポスト II
- 歯科セラミックス用 ③ クリアフィル® セラミック プライマー プラス 接着材料

※製品画像に付与された番号を参照ください。

2 ボンド塗布

待ち時間なしで③へ



3 マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※1

5秒以上乾燥



4 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間	「ベンキュアー 2000」の 高出力モードの場合は3秒、 標準モードは10秒 (製造販売元:株式会社 モリタ製作所)
高出力LED照射器	5秒	光量についてはP.2を参照ください。
LED照射器	10秒	
ハロゲン照射器		

5 ペーストの填入※2



6 ポスト植立・光照射



「ペーストへの照射時間と硬化深度の関係 (歯科重合用光照射)」の表を参照

7 ペーストの築盛・光照射※3,4 ・支台歯形成



ペーストへの照射時間と硬化深度の関係 (歯科重合用光照射)

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300 mW/cm ² 以上	10秒	1.5 mm
			20秒	2.0 mm
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	300 mW/cm ² 以上	10秒	1.5 mm
			20秒	2.0 mm

POINT

- ※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。
- ※2 ポストの植立は1分以内に行ってください。
- ※3 舌側と唇側の2方向より所定時間光照射してください。
- ※4 光硬化深度以上に築盛する場合は光照射後6分以上静置してください。